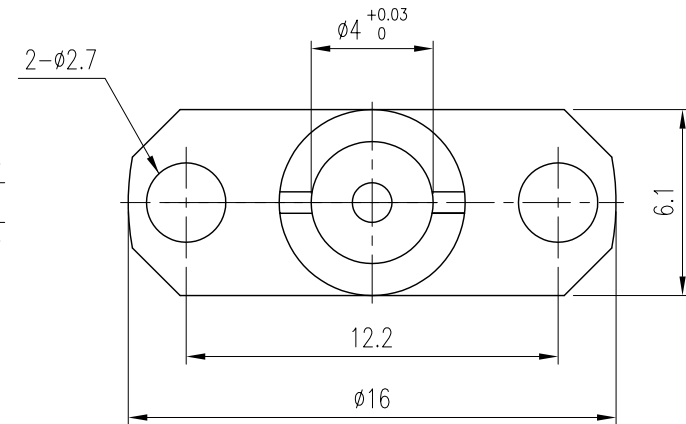
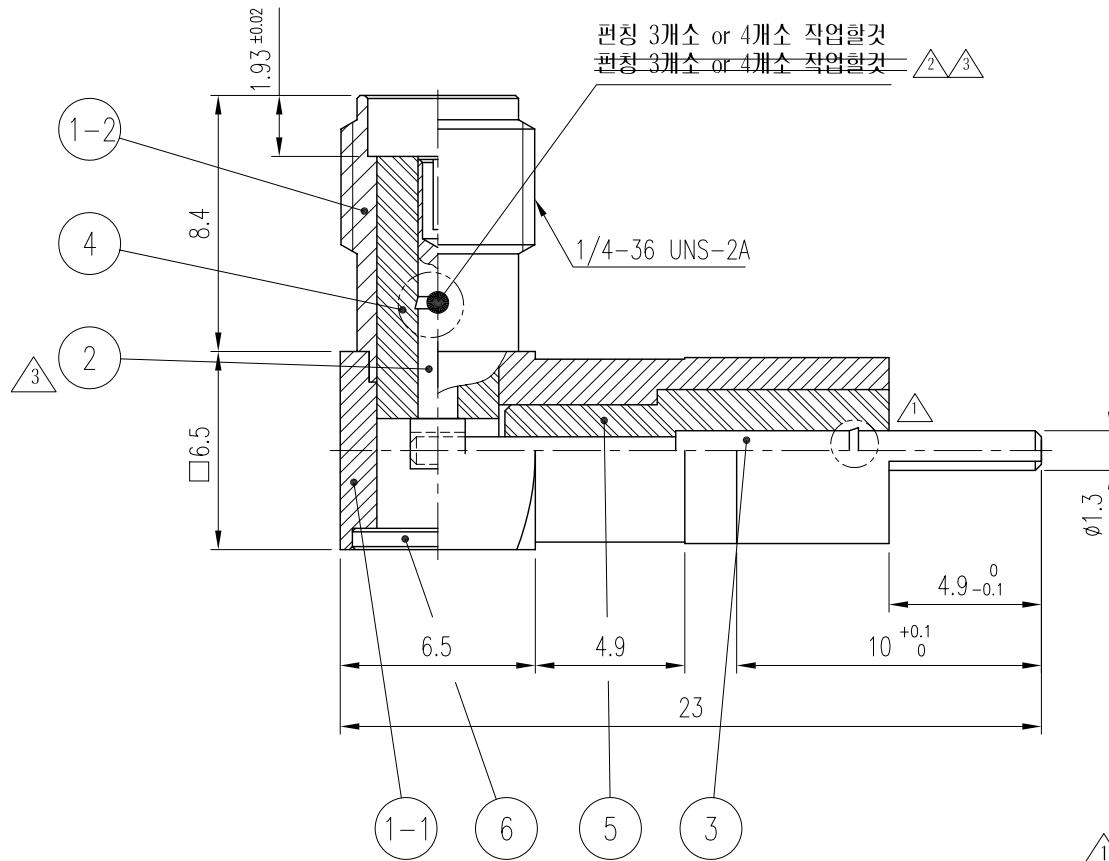


수 정 내 용									
부호	내 용	수정자	승인자	년	월	일			
1	생산상 황상(질번No. 2005-168) (뿔공정시 PN 밀려현상 개선으로 인한 뿔시바늘 추가)	김인철	최충락	2005.	7.	20.			
2	조립상 황상(질번No. 2006-037) (BODY와 절연체 위치개공 적용으로 인해 편칭부위 삭제)	김인철	최충락	2006.	2.	14.			
3	신뢰성 황상(질번No.연구2006-149) (PN 밀려 뿔자 뿔시바늘 삽입)	김인철	윤상진	2006.	7.	27.			



6	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCO00042-5/1 (L2003)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00243-N/1 (H2193)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00112-N/1 (H2031)
3	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00118-5/1 (E2266)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00151-5/1 (E2127)
1	1-2 BODY(B)	1	MBsBD	Gold Plate	DBB00021-5/1 DBD00281-3/1 DBD00208-3/1
	1-1 BODY(A)	1	MBsBD	Gold Plate	

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고	
공통공차 .* ±0.1 .*.* ±0.05	년월일	2004. 4. 8.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD. SMA-LJ-H2-2R-R_{VER.3}			
	승인							
재질	검도				도명			
	재도							
열처리	작성부서				A4	도번 CN01207-7/1 K314-636-000		
	연 구 소							
보호파막처리	척도 4/1	단위 mm	중량					